

越简单越好



型号 6200

自动
贴片系统

执行MCM、倒装芯片、共晶、银玻璃、银烧结等贴片应用。

占用空间小，台式配置。

多功能、用户友好设备，使用与6400型相同的高级软件，运行在Windows®PC。

全自动和半自动工艺，灵活性高、操作方便。

高精度伺服系统控制主轴。

高分辨率数字视觉和高级图像处理系统。

时间-压力、体积或喷射点胶机，适用于热固化或UV固化粘合剂。

双点胶机，适用于2种不同的粘合剂。

冲压（引脚转换）75 μm胶点。

芯片：

- 多达10个网格板/2英寸凝胶包装。
- 多达8个磁带和卷轴馈线。
- 散装和其他馈线。
- 以上的组合。

独有的1次通过，湿片堆叠能力与块材料BLT控制。

处理MEMS、传感器、成像设备等。

使用浆料或银片，烧结多片银。

倒装芯片、C2/C4工艺，包括芯片翻转、凹凸磁通和高分辨率仰视相机的最终对齐。

基于超声波、热压缩、ACF/ACP的金凸块倒装芯片

共晶 MCM 温度高达500°C，工艺基于加热基板和加热拾取工具，提供成型气体。

规格参数

工作区域：最大6×6英寸

芯片尺寸：0.006 英寸至 2 英寸以上

芯片材质：砷化镓、硅、玻璃等。

基板：引线框架、陶瓷、硅片、PCB、金属、激光二极管模块等。

拾取/粘合力：40至9000克。

放置精度：优于±3 μm ——取决于应用。

生产量：高达600 CPH——取决于应用程序。

工作区：最大6×6英寸，台式。

重量：200kg以下。



以色列约克尼穆市2069200贝特里蒙，MAT有限公司
电话 972-4-959-2225 传真 972-4-959-2226 主页www.mat-ltd.com